

252P 系列

开机成本低

- 面向教育科研用户，成形缸较小，因此开机需要的材料少，开机成本低。

材料适应广

- 采用滚筒铺粉方式，对于材料的适用性非常强，打印成功率高。

操作维护易

- 用户体验非常人性化，活塞清洁位置设计科学合理，粉末清理十分便捷。

烧结温度高

- HT252P具有220°C高温烧结能力。UT252P具有340°C超高温烧结能力，能够打印PPS、PEEK等材料。

深度开源

- 主要的温场和能量参数开放用户，非常适合科研培训与新材料的研发应用。



样品名称：PEEK新材料医疗件

打印设备：UT252P

打印材料：PEEK

该样件采用了华曙高科全新开发超高温高分子材料3D打印解决方案，并实现340°C熔点高温材料稳定高效烧结。PEEK材料的成功烧结，也标志着华曙高科高分子3D打印设备全面覆盖190°C-340°C的材料烧结温度。满足各行业材料烧结需求。

技术参数	HT252P	UT252P
外形尺寸 (W×D×H)	1735×1225×1975mm	1735×1300×2000mm
成形缸尺寸 ¹ (W×D×H)	250mm×250mm×320mm	
设备净重	约 1700kg	约 2200kg
铺粉层厚	0.06~0.3mm可调	
扫描速度	最高达 10m/s	
激光系统	CO ₂ 激光器, 55W	CO ₂ 激光器, 100W
振镜扫描系统	定焦	
最高建造腔体温度	220°C	340°C
热场控制	智能分区独立控制	
温度控制	连续实时表面温度监测	
操作系统	64 位 Windows10	
数据处理及系统控制软件	BuildStar, MakeStar®	
软件功能	开源参数调节，可实时修改建造参数，三维可视化，诊断功能	
数据格式	STL	
电源要求	380V±10%，3~N/PE，50Hz/60Hz，25A/40A	
运行环境温度	22-28°C	
成形材料	FS3300PA, FS3401GB, FS4100PA, FS6140GF, WANFAB-PU95AB, Ultrasint® TPU 88A black, PEEK (仅UT)等	

¹ 实际成形体积与材料、工件等要素相关。

©Farsoon 2025 此技术参数表版权归华曙高科所有，不受合同约束，未经华曙高科许可不得转载，不得将其视为对华曙高科公司或任何子公司、联营公司有关任何合同或其他承诺的约束。